

证券简称：灿芯股份

证券代码：688691

灿芯半导体（上海）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称	工银瑞信基金、平安养老保险、中金公司、国金证券
时间	2025 年 6 月 10 日
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书沈文萍女士 证券事务代表石啸天、梁砚卿
投资者关系 活动主要内容 介绍	公司情况简要介绍： 灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型 SoC 定制设计技术与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系。 依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市等行业。 2024 年度，公司实现营业收入 108,966.12 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,104.72 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司在手订单 8.99 亿元，其中设计业务在手订单 3.40 亿元，量产业务在手订单 5.59 亿元。公司截至 2025 年第一季度末的在手订单金额环比增长 11.38%，呈现回升态势，为公司后续业务发展奠定良好基础。 投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：

	1、公司 2025 年第一季度芯片设计项目的进展情况？ 答：2025 年第一季度，公司多个芯片定制项目进入设计阶段且预计将于本年度内流片；如公司提供设计服务的充电桩电源主控芯片项目，该芯片在国产自主工艺平台上实现全部国产化设计，内嵌 RISC-V 核及多个公司自主研发的高性能模拟 IP；公司提供设计服务的 LED 显示驱动芯片项目，该芯片在国产自主工艺平台上实现全部国产化设计，内嵌 RISC-V 核及公司自主研发的 PSRAM IP，芯片在面积、成本等方面均较前代产品实现大幅提升；公司提供设计服务的 MRAM 控制芯片项目，该芯片在国产自主工艺平台上进行逻辑控制设计，实现了国产 MRAM 存储的突破，且基于其成本方面的优势，可在后续 SoC 设计过程中逐步替换外挂 FLASH 及片上 SRAM 等低速应用场景，该芯片预计后续将进行多次迭代，具有较大的商业化前景。 2、公司在高速接口 IP 和高性能模拟 IP 方面的研发进展？ 答：在人工智能、数据中心及智能汽车等领域的强劲需求驱动下，高速接口 IP 技术正加速迭代，成为芯片设计的核心支撑之一。公司在多工艺平台 IP 研发领域取得多项积极进展。基于 28HKC+工艺平台的 DDR、SerDes、PCIe、MIPI、USB 等高速接口 IP 已完成验证并实现量产交付，能够为数据中心 AI 加速芯片、车载 SoC 等高性能场景需求提供支持，同时上述 IP 集成先进信号完整性（SI）和电源完整性（PI）设计，能够提升 IP 在复杂电磁环境下的可靠性。在 28HKD 工艺平台上，全线 DDR、SerDes、PCIe、MIPI、USB IP 完成客户小批量验证，新增的 PSRAM 和 EMMC IP 产品线进一步补充了公司在低功耗存储接口领域的布局。同时结合 3D 封装技术优化 IP 互连效率，上述 IP 适配 Chiplet 架构对高带宽、低延迟的需求，能够助力客户实现异构集成设计。在高性能模拟 IP 方面，公司自研的 4.5GHz 小数分频锁相环（PLL）通过高精度与高频性能核心特性与能力，为多工艺平台的一站式芯片定制业务提供关键技术支撑，可广泛应用于物联网、工业控制、消费电子及网络通信等领域，为不同行业提供定制化时钟解决方案。该 IP 的通用性设计兼顾高性能与灵活性，适配不同工艺需求，增强了一站式定制服务的差异化竞争力。综上，公司通过工艺平台扩展与 IP 产品线完善，构建了覆盖成熟制程到先进封装的技术矩阵，能够为 AI 芯片、汽车电子等领域的客户提供兼具性能、可靠性和灵活性的解决方案。
--	---

	3、公司车规芯片平台目前的进展情况？ 答：近年来随着汽车在智能化、电气化和网联化方面的不断深入发展，高性能车规 MCU 的重要性与日俱增，作为汽车智能化、电动化的“大脑”，其作用亦从传统控制扩展到数据处理、数据保护和生态协同等，在基础控制功能之外还涉及到复杂的数据处理、实时决策和安全保障的功能需求，是汽车电子领域重要的组成部分及未来重要的发展方向之一。公司自研的车规 MCU 平台在 2025 年第一季度已进入流片环节，该平台采用双核设计，通过冗余核、ECC 内存、故障自检（BIST）等机制保证了芯片性能，同时通过锁步核（Lockstep Core）实时比对运算结果从而检测硬件故障提供了安全保障。总体而言，公司自研的车规 MCU 平台具有高性能、强稳定性、多重数据保护能力、高实时性、外设接口丰富等特点，上述特点亦使得其能够适用于多个应用场景，包括动力控制总成（如新能源车的电机控制、燃油车的燃油喷射控制等），底盘系统（如电子稳定程序、主动悬架控制等），传感器融合等。依托公司在车规 MCU 方面的投入、丰富的自有 IP 以及芯片定制方面的项目经验和技術优势，公司未来能够满足汽车电子领域不同客户的多样性需求，强化公司在该领域的核心竞争力。 4、公司的研发投入情况及后续的研发规划是怎样的？ 答：2024 年度，公司研发投入金额为 1.28 亿元，研发投入比例达到 11.73%。截至 2024 年末，公司共有研发人员 155 人，较去年同期末增加 45 人，研发人员占比达到 45.32%。研发人员中，硕士及以上学历 93 人，占研发人员总数的 60.00%。公司未来将根据自身战略进行研发布局，始终重视研发投入及研发团队建设，持续提高公司竞争力。 5、公司对未来发展的展望？ 答：公司将继续专注于为客户提供一站式芯片定制服务，致力于为客户提供高价值、差异化的解决方案。凭借成熟的行业应用解决方案、优秀的芯片架构设计能力和丰富的芯片设计经验，帮助客户高效率、高质量完成芯片的定义、设计和量产出货。公司后续主要经营计划包括： （1）技术研发创新：公司将进一步加大研发投入，提升自主创新能力、完善研发体系与质量管理体系，对现有的以大型 SoC 定制设计技术与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系进行持续研发，不断为客户提供高质量、高效率、低成本、低风险的一站式芯片定制服务。 （2）市场拓展：一方面，公司将加强市场开拓力度，重点布局汽车电
--	---

	子、端侧 AI、AI+IoT 等高潜力领域，加速技术研发成果的市场化应用，增强公司核心竞争力；另一方面，公司将拓展销售与服务网络的覆盖度，提升销售团队整体专业素质，优化公司营销模式。 （3）研发团队建设与管理效能提升：公司重视人才引进，立足公司实际情况，积极同国内外科研院所、高校和企业进行交流，注重国内外高端专业技术人才的引进。与此同时，公司实施人才培养计划，健全公司内部培训、人员考核评价、晋升及优化机制，加强公司在创新文化、员工职业生涯规划、内部知识共享、员工领导能力建设方面的投入，持续提升员工队伍素质。此外，公司还将优化管理流程，提升流程效率，优化整体管理效能，降低公司运营成本 （4）并购重组与资源整合：在高度竞争的产业形势下，公司将在自身成长的同时，积极寻求并购机会，从而使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。公司将综合评估标的公司的管理团队和企业文化与公司的兼容性，保障公司核心竞争力的加强和进一步发展。
附件清单	无
日期	2025 年 6 月 10 日
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无